

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—026

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	国盛证券：何鲁丽 中泰证券：陈鼎如 汉石基金：王辉、范锦鸽、慕陶 浙商证券：王华君、蒋逸 国海证券：杜先康 保银基金（pinpoint）：白鹏宇 长城证券：王宁、汪湛帆 上海粒子跃动：孙祥祥 朱雀基金：李文龙 野村东方国际：徒月婷、张帆 博通基金：钱程 东方基金：吕燕晨 东吴证券：吴劲草 红骅投资：吴胜勇
时间	2026年6月30日
地点	国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 董事会办公室主任：赵金伟
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1. 问：超硬材料磨具业务开展情况如何？</p> <p>答：2025年超硬磨具业务收入6.7亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。</p> <p>2. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？</p> <p>答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片</p>

	<p>和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K；金刚石铜复合材料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。</p> <p>3. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？</p> <p>答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。</p> <p>在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。</p> <p>4. 问：公司金刚石散热产品是否还存在降本空间？</p> <p>答：一方面，公司的新疆哈密产业园规划用于合成金刚石，利用当地低价电能降低成本；另一方面，推进全产业链技术迭代，包括晶种片、设备、沉积工艺、加工环节的技术创新来进一步降低成本。</p> <p>5. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？</p> <p>答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。产品种类上，金刚石工具类已覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等产品类型，精密陶瓷制品类已覆盖陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品类型。</p> <p>6. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？</p> <p>答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文</p>	<p>无</p>

稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
----------------------	--